

# 智慧電子人才應用發展推動計畫 112 年度核心實務學程入選班級

## ◎正取班級

序號	開班單位(依筆劃排序)	課程名稱	政府經費 <sup>1</sup> (元)
1	國立臺灣科技大學	晶片佈局核心實務學程	800,000
2	中華大學學校財團法人中華大學	先進製程積體電路佈局工程師核心實務學程	800,000
3	中華行動數位科技有限公司	嵌入式 FPGA 系統晶片設計實戰核心實務學程	800,000
4	中原大學	測試工程師核心實務學程	600,000
5	中華大學學校財團法人中華大學	IC 應用工程師核心實務學程	800,000
6	財團法人資訊工業策進會	大數據分析核心實務學程	240,000
7	財團法人資訊工業策進會	IC 製程工程師核心實務學程(二)	800,000
8	明新學校財團法人明新科技大學	IC 封裝工程師核心實務學程	600,000
9	正修學校財團法人正修科技大學	IC 封測設備與廠務工程師人才養成核心實務學程	800,000
10	財團法人資訊工業策進會	IC 封裝核心實務學程	800,000
11	艾錡科技有限公司	生醫訊號處理工程師核心實務學程	600,000
12	台灣車用電子協會	車載系統可靠度驗證測試人才核心實務學程(台南班)	800,000
13	財團法人資訊工業策進會	智慧系統整合核心實務學程	360,000
14	國立高雄大學	人工智慧與數據分析於智慧製造之人才培訓班核心實務學程	800,000

<sup>1</sup> 政府經費以每班 20 人編列，實際執行金額依符合結訓認列學員人數撥付。

◎備取班級<sup>2</sup>

序號	開班單位(依筆劃排序)	課程名稱	政府經費 <sup>1</sup> (元)
1	中華行動數位科技有限公司	嵌入式 AI 應用人才實戰核心實務學程	800,000
2	財團法人資訊工業策進會	IC 製程工程師核心實務學程(一)	800,000
3	台灣車用電子協會	車載系統可靠度驗證測試人才核心實務學程(台北班)	800,000

---

<sup>2</sup> 備取班級將視整體開班狀況及經費運用情形，由計畫辦公室另行通知開班單位遞補開班及招生。